

锦州神工半导体股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



二〇二〇年五月

目录

2019 年年度股东大会会议须知.....	3
2019 年年度股东大会会议议程.....	6
一、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	8
二、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	9
三、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	14
四、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	17
五、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	19
六、《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》	20
七、《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》	21
八、《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》	22
九、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	23

2019年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》、《锦州神工半导体股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2019年年度股东大会会议须知：

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券办公室严格按照程序安排会务工作。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前向股东大会会务组进行登记。股东大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不宜过长。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议政策程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-011）。

特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:00 开始

会议地点：锦州市太和区中信路 46 号甲公司会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长潘连胜先生

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、见证律师确认与会人员资格；
- 三、主持人宣布会议开始；
- 四、主持人宣读会议须知；
- 五、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
 - 2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
 - 3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
 - 4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
 - 5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
 - 6、《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》；
 - 7、《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》；
 - 8、《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》；
 - 9、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。
- 六、股东或股东代表进行讨论；
- 七、选举监票人和计票人；
- 八、与会股东与股东代表对各项议案投票表决；
- 九、统计并宣布现场表决结果；
- 十、休会，等待接收网络投票结果；
- 十一、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

十二、主持人宣读股东大会决议；

十三、见证律师宣读法律意见书；

十四、签署会议文件；

十五、主持人宣布会议结束。

一、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东和股东代表：

公司已于 2020 年 4 月 25 日披露了《锦州神工半导体股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要，具体内容可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》查阅。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。

2020 年 5 月 19 日

二、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告

一、2019 年公司经营概述

2019 年，由于全球半导体市场需求下滑，固态存储及智能手机、PC 需求增长放缓，导致全球半导体行业整体库存水平较高，同时全球摩擦升温也对半导体贸易市场造成了较大影响。根据 WSTS 统计，2019 年全球半导体市场销售额 4,121 亿美元，同比下降了 12.1%，出现了自 2008 年以来的首次两位数负增长。

公司主要产品刻蚀用单晶硅材料的市场需求与半导体行业景气度密切相关。由于公司主要产品处于半导体产业链上游，终端需求变化反应到公司产品的销售变化上存在一定的滞后时间。2019 年一季度，在半导体行业终端整体出现销售下滑迹象的情形下，公司的销售情况依然保持 2018 年度的景气状态，且销售额同比上升。2019 年二季度以来，受中美贸易摩擦、日韩贸易摩擦、智能手机、数据中心、汽车等终端需求增长乏力、5G 普及未及预期等因素影响，全球半导体市场需求持续下滑，公司客户基于对下游需求的趋势判断调整自身库存水平，从而减少采购金额，导致公司 2019 年度收入减少。

2019 年全年，公司实现营业收入 18,858.60 万元，较上年同期下降 33.25%；归属于上市公司股东的净利润 7,694.98 万元，较上年同期下降 27.80%；经营活动产生的现金流量净额 11,286.52 万元，较上年同期下降 1.20%。

面对挑战与机遇，公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕公司战略目标，积极进行市场开发，持续深化技术提升，不断优化管理能力，推动公司高质量发展。

(一)公司积极进行市场开发。报告期内公司参加了上海半导体展“SEMICON CHINA”，通过与上下游伙伴单位和业界好友交流互动，共谋未来发展，树立了良好的公司品牌形象；同时，公司在所在地积极组织行业交流会，邀请国际顶尖集成电路刻蚀机零部件生产厂商参加，展示公司生产实力，相互交流行业资讯，探讨市场动态及发展趋势，准确把握客户需求、高效维护客户关系。

此外，公司抓住国内半导体行业快速发展机遇，积极培育国内市场。公司通过子公司福建精工向中微半导体设备（上海）股份有限公司提供电极产品进行认证，谋求共同发展，推动半导体行业国产化的进程。

（二）公司持续深化技术提升和品质管理水平，报告期内公司主要产品的成品率水平持续提升，生产成本呈现下行趋势。同时，公司芯片用单晶硅晶体生长研发工作进展顺利，目前公司已摸索出了适合的工艺窗口，积累了一定的技术数据。通过对晶体缺陷控制工艺的深入分析，公司芯片用单晶硅晶体的生长工艺得到改善，为实现 8 英寸低缺陷单晶硅材料的规模化生产奠定了坚实基础。

公司“半导体刻蚀机用无磁场 28 吋热场量产 19 吋硅单晶技术”通过了中国电子材料行业协会组织的院士和业内专家为主的技术评审专家组评审，认定公司该项技术填补了国内空白，达到国际先进水平。

（三）公司不断优化管理能力，对外加大了对优秀人才特别是复合型管理人才、技术型人才、销售型人才的引进力度，对内注重员工的技能培训和梯队建设，为公司的持续健康发展做好人才储备。同时，公司不断完善并优化公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

二、行业格局和趋势

经过半个世纪的发展，半导体广泛渗透于信息、通信、计算机、消费电子、汽车等各个领域，半导体产品对人们的日常生活和消费形态产生了显著的影响。5G、人工智能、物联网、大数据等新应用领域的兴起，逐渐成为半导体行业下一代技术革新的驱动力量。半导体产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人民生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。

长期来看，半导体行业的增速波动与全球 GDP 波动的相关性呈现高度一致（2010 至今，相关系数为 0.57）。半导体行业存在受 GDP 增速影响的需求周期在行业内已成为共识。另一方面，半导体产业分工的出现使得行业出现了以核心

企业的产能波动为主导的供给周期。综合来看，以 GDP 增速表征的需求周期和行业龙头产能变化的供给周期两个因素共同叠加，构成了半导体周期。

2016 年度至 2018 年度，全球半导体行业处于行业周期上行阶段，行业景气度较高，带动半导体材料特别是硅材料市场需求增长。2019 年以来，终端市场需求有所放缓，加之全球半导体产业出现了一定的反全球化的现象，导致半导体材料行业市场规模有所缩减，但下降幅度低于整体半导体产业。根据 SEMI 统计，2019 年全球半导体材料市场销售达 520 亿美元，较上年略微下降 1.1%。其中，全球晶圆制造材料总营收从 330 亿美元降至 328 亿美元，微幅减少 0.4%；封装材料营收下滑 2.3%，由 197 亿美元降至 192 亿美元。但长期来看，全球半导体行业仍处于螺旋式上升的发展趋势。

相比全球半导体市场，中国半导体市场虽受全球整体因素影响，但依旧保持了相对良好的走势。据中国半导体行业协会统计，2019 年中国集成电路产业销售额为 7562.3 亿元，同比增长 15.8%。其中，IC 设计业销售额为 3063.5 亿元，同比增长 21.6%；IC 制造业销售额为 2149.1 亿元，同比增长 18.2%；IC 封装测试业销售额 2349.7 亿元，同比增长 7.1%。

我国政府先后出台了一系列规范和促进集成电路行业发展的法律法规和产业政策，同时通过设立产业投资基金、鼓励产业资本投资等多种形式为行业发展提供资本助力。

三、公司发展战略

公司以“科技创新、技术报国”为宗旨，以“专注技术、强调质量、服务客户”为经营理念，致力于成为在全球半导体级单晶硅材料领域内，有市场地位、有技术优势和研发实力、有高性价比产品、有良好品质管理及售后服务的优秀硅材料供应商。

未来，公司将继续依托自身的技术优势及丰富的半导体市场经验，增加技术研发投入，提高生产管理效率，并紧密围绕“半导体材料国产化”的国家战略，成为中国乃至世界半导体硅材料领域的领先者。

四、2020 年经营计划

近年来，国内半导体材料市场发展迅猛，据 SEMI 报告指出，2019 年国内半导体材料营收达 88.6 亿美元，同比增长 1.9%，也是全球唯一出现增长的材料市场。虽然中国半导体行业整体销售规模持续扩张，但半导体材料及设备依然严重依赖进口，国产化进程严重滞后于国内快速增长的市场需求，进口替代空间巨大。

公司是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅电极材料供应商，主营业务为集成电路刻蚀用单晶硅电极材料的研发、生产和销售。2020 年，公司拟定如下经营目标：

（一）在刻蚀用单晶硅材料领域

紧跟行业前沿客户的研发步伐，加大力度开发超大尺寸硅电极用单晶硅材料。在公司已初步掌握的 22 英寸超大直径单晶硅材料拉制技术的基础上，进一步优化工艺，添置专用设备，力争早日实现超大直径产品规模化量产，不断夯实公司先发优势，构建技术壁垒，巩固公司在全球范围内的竞争地位。

在市场开拓上，公司将继续深耕重点客户，在巩固与重点客户长期稳定的良好合作关系同时，注重与国内半导体行业新兴客户及终端 IC 客户的接触，逐步建立并完善起国内的销售网络，抓住国内半导体行业发展的机遇，扩大国内市场销售的份额。

（二）在芯片用单晶硅材料领域

公司前期已储备了一定的 8 英寸低缺陷晶体生长的技术，接下来，将进一步向硅片加工工序延伸，生产出 8 英寸硅单晶抛光片（含测控片）。公司计划使用募集基金购置硅片加工所需要的全套生产及检测设备，力争在 2020 年年内，打通 8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产完整链条，并逐步优化调整设备工艺，确保公司产品可对标日本信越化学、日本 SUMCO 等国际一流厂商抛光片质量标准。

为此公司制定了详尽的生产启动、工艺提升计划，一方面力争实现年内量产 8,000 片/月的生产规模，另一方面，利用在行业中长期积累的丰富客户资源及良好的品牌知名度，加速 8 英寸硅抛光片的客户认证工作，为后续扩产工作奠定基础。

（三）在人才引进上

2020年，面对国内半导体高端人才紧缺的局面，公司将着眼于国际半导体行业，引进有着丰富生产、管理经验的复合型专家；同时吸纳国内有一定基础的中端技术人员；建立起自己的技术人才梯队，提升公司的人才竞争优势。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2020年5月19日

三、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019年度财务决算报告

2019年度，锦州神工半导体股份有限公司年财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字（2020）1-01561号标准无保留意见的审计报告，公司财务决算情况如下：

一、2019年总体经营业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入18,858.60万元，其中14英寸以下产品实现收入620.91万元，比上年同期减少了43.18%；14-15英寸产品实现收入3,547.31万元，比上年同期减少60.82%；15-16英寸产品实现收入10,926.04万元，比上年同期减少30.28%；16-19英寸产品实现收入3,755.21万元，比上年同期增加54.13%。实现营业利润9,107.01万元，较上年同期减少26.93%；归属于上市公司股东的净利润7,694.98万元，较上年同期减少27.80%；经营活动产生的现金流量净额为11,286.52万元，较上年同期减少1.20%。

二、报告期内公司经营业绩分析

1、资产状况

公司2019年末总资产38,464.83万元，同比增长6.56%；负债总额2,394.34万元，同比减少10.04%，归属于上市公司股东的所有者权益总额36,070.49万元，同比增加7.88%；资产负债率为6.22%。

其中，（1）货币资金较上期末增加130.24%，主要系公司本年净利润增加所致；（2）应收账款较上期末减少62.91%，主要系下半年销售收入下降所致；（3）预付账款较上期末减少87.16%，主要系公司合理控制原材料库存所致；（4）存货较上期末增加23.87%，主要系公司根据2020年市场预期，合理控制库存所致；（5）固定资产较上期末增加41.33%，主要系构建房产、采购大型研发设备以及在建设工程转固所致；（6）在建工程较上期末减少98.61%，主要系房产、大型研发设备转固所致；（7）长期待摊费用较上期末增加85.56%，主要系新厂区建设中路面、围墙等增加所致；（8）其他非流动资产较上期末减少89.85%，主要系

公司预付的工程、设备等长期资产款项减少所致；（9）应付账款较上期末减少36.53%，主要系公司合理控制原材料库存所致。

2、期间费用及所得税费用分析

单位：人民币万元

费用项目	2019年度	2018年度	同比增减幅度（%）	2017年度
销售费用	292.46	289.29	1.09%	150.07
管理费用	2,654.58	4,653.44	-42.95%	932.49
财务费用	-137.94	-225.03	38.70%	41.97
所得税费用	1,297.76	1,765.25	-26.48%	756.01

（1）管理费用较上年同期减少42.95%，主要系18年股份支付计入管理费用3423万元，19年未发生股份支付所致；

（2）财务费用较上年同期增加38.70%，主要系汇兑损益增加所致。

3、现金流量状况

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	236,213,791.60	320,837,327.81	-26.38%
经营活动现金流出小计	123,348,613.34	206,602,956.95	-40.30%
经营活动产生的现金流量净额	112,865,178.26	114,234,370.86	-1.20%
投资活动现金流入小计	109,046,164.38	150,530,271.57	-27.56%
投资活动现金流出小计	108,713,825.26	277,899,145.94	-60.88%
投资活动产生的现金流量净额	332,339.12	-127,368,874.37	100.26%
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	50,485,766.00	1,797,531.77	2,708.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,485,766.00	33,202,468.23	-252.05%
现金及现金等价物净增加额	63,187,797.48	20,400,839.15	209.73%

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.26%，主要系2018年度公司新建厂房并在当年建设完成同时购置研发设备所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少252.05%，主要系2018年公司收到股东投入资本金3500万元，而2019年公司分配上年利润5048万元综合影响所致。

4、主要数据及财务指标

单位:人民币元

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
营业收入(元)	188,586,021.47	282,535,675.83	-33.25	126,420,742.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,949,820.93	106,575,958.78	-27.80	45,852,756.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	76,184,570.27	132,852,815.41	-42.65	44,900,176.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,865,178.26	114,234,370.86	-1.20	31,992,587.92
基本每股收益(元/股)	0.64	0.9	-28.89	--
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.9	-28.89	--
净资产收益率(%)	22.16	41.76	-19.60	39.65
	2019年末	2018年末	本年末比上年 末增减(%)	2017年末
总资产(元)	384,648,253.60	360,966,180.04	6.56	175,519,940.51
归属于上市公司股东的净资产(归属 于上市公司股东的所有者权益)(元)	360,704,903.17	334,351,434.96	7.88	158,528,304.78

锦州神工半导体股份有限公司
董事会

2020年5月19日

四、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为锦州神工半导体股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2020 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划等，按照合并报表口径进行测算并编制。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2020 年度主要财务预算指标

2020 年度公司预算目标：以 2019 年的营业收入为基数，2020 年的营业收入增长率在 0%-20%之间；2020 年净利润增长率在 0%-20%之间，上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

四、风险提示

上述财务预算仅为公司 2020 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，

并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

锦州神工半导体股份有限公司

2020年5月19日

五、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

各位股东和股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 100,204,534.87 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。目前公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.19%。

本次利润分配完成后，公司剩余可分配利润结转至下一年度。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

2020 年 5 月 19 日

六、《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求。董事会拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会结束时止。2020 年度财务报表审计费用为 60 万元，内控审计费用为 20 万元，与 2019 年度相同。上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

2020 年 5 月 19 日

七、《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东和股东代表：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定 2020 年度公司董事薪酬方案如下：

非独立董事：公司不额外向公司非独立董事支付董事职位薪酬。

独立董事：公司向独立董事支付津贴，标准为每人每年度税后人民币 7.2 万元，按月发放。上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

2020 年 5 月 19 日

八、《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东和股东代表：

公司不额外向公司监事支付监事职位薪酬。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

2020年5月19日

九、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告

2019年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职能认真规范地开展了工作，对公司依法运作情况，公司财务状况，董事、总经理及高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。现将一年的工作情况报告如下：

一、监事会2019年度工作

（一）监事会会议情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会职责划分合理、清晰，并能得到切实执行。监事会按照公司章程和议事规则独立有效运行，召集、召开、表决、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，运作记录规范、完整。

2019 年度公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了如下项议案：

会议名称	通过议案	
	序号	议案名称
第一届监事会第二次会议	1	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
	2	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
	3	《关于公司最近三年（2016 年-2018 年）财务报告的议案》
	4	《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
	5	《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
	6	《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
	7	《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
第一届监事会第三次会议	1	《关于制定<锦州神工半导体股份有限公司章程（草案）>的议案》

议	2	《关于修订<锦州神工半导体股份有限公司内部控制制度>的议案》
	3	《关于修订<锦州神工半导体股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
	4	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》
	5	《关于制定<锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市后前三年股东分红回报规划>的议案》
	6	关于审议<原始财务报表与申报财务报表的差异比较表>、<非经常性损益明细表>、<主要税种纳税情况的说明>的议案》
第一届监事会第四次会议	1	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》
	2	《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
	3	《关于提请召开锦州神工半导体股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第一届监事会第五次会议	1	《关于公司会计政策变更的议案》
	2	《关于公司 2019 年第一季度财务报告的议案》
第一届监事会第六次会议	1	《关于公司最近三年及一期（2016 年度-2018 年度及 2019 年 1-6 月）财务报告的议案》
	2	《关于公司 2019 年上半年度内部控制评价报告的议案》
	3	《关于审议<原始财务报表与申报财务报表差异审核报告>、<非经常性损益审核报告>、<主要税种纳税情况及税收优惠审核报告>的议案》
第一届监事会第七次会议	1	《关于公司 2019 年第三季度财务报告的议案》

（二）检查公司财务情况

2019年，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，通过检查和审核，监事会认为2019年财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

（三）审核公司内部控制情况

公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制

严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。

（四）股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规和《公司章程》，对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行自己的职责情况以及对公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会决策程序严格遵循相关法律法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东大会的各项决议，运作规范，未发生有损股东利益的行为。

二、监事会2020年度工作计划

2020年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，不断加强监督检查，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。

锦州神工半导体股份有限公司

监事会

2020年5月19日